



TO263-7L 封装型式

1、低寄生电感设计：

通过多引脚并联（如 5 根源极引脚并联）和 Kelvin 源极结构，显著降低封装寄生电感 (<1nH)，减少开关过程中的振荡和噪声，支持高频开关（如 1MHz 以上），降低开关损耗。



2、高功率密度与散热性能：

基岛面积大，可适配大尺寸芯片，结合鸥翼脚布局和背面散热板，散热效率高，适用于高功率密度场景（如电动汽车充电、光伏逆变器）。



3、高电流承载能力：

漏极引脚接合面积大，源极引脚可多根并联，部分产品脉冲电流能力可达 500A，满足大电流应用需求。



4、表面贴装 (SMT) 兼容性：

作为贴片式封装，支持自动化生产，焊接简便，相比传统插件封装体积更小，利于系统小型化。